

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

**关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司支付）的方式，购买：深圳市富创优越科技有限公司（以下简称“富创优越”）9.93%股权、深圳市润锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额，并向东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳华盛”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年11月7日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）（2025）91号）（以下简称“《审核问询函》”）。上交所依据相关规定对公司报送的本次交易的申请文件进行了审核，并形成了问询问题。公司及相关中介机构根据《审核问询函》所列问题进行了逐项研究和认真落实，对相关事项逐一进行说明回复，并对公司于2025年9月30日披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了相应的修订、补充和完善。

相较于2025年9月30日披露的重组报告书，本次主要修订情况如下：

| 章节 | 修订情况 |
|----|--------|
| 释义 | 补充相关释义 |

| 章节 | 修订情况 |
|----------------------|---|
| 重大事项提示 | 补充完善本次重组中各交易对方的总对价、交易单价及支付方式等信息，补充完善业绩承诺中减值测试及补偿安排的相关内容 |
| 重大风险提示 | 补充关于商誉减值风险的相关量化分析 |
| 第四节 交易标的基 本情况 | 调整更新交易标的历史沿革、产能、主要客户情况等相关内容 |
| 第九节 管理层讨论 与分析 | 补充更新了光模块 PCBA 竞争情况、标的公司盈利能力分析等相关 内容 |
| 第十二节 风险因素 分析和风险提示 | 补充关于商誉减值风险的相关量化分析 |

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，详见重组报告书楷体加粗部分内容。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 1 日